

第 34 回マイクロエレクトロニクス研究会プログラム

2022 年 11 月 12 日

会場:TKP ガーデンシティ仙台 ホール C, D (21F)

13:10~13:45 「先進イメージング技術と半導体製造・多分野応用」

東北大学未来科学技術共同研究センター
東北大学大学院工学研究科
黒田 理人

13:45~14:20 「A Study on High Precision and High-Speed Time-of-Flight CMOS Image Sensor for Range Imaging」

東北大学大学院 工学研究科 技術社会システム専攻
郭 家祺

14:20~14:55 「変則マルチピクセルセンサーによる高効率な多視点イメージングと位相差 AF 技術」

キヤノン株式会社 ICB 統括第一開発センター
東北大学 大学院工学研究科
福田 浩一

14:55~15:10 休憩

15:10~15:45 「オープンコラボレーションによる MEMS 研究開発」

東北大学マイクロシステム融合研究開発センター
戸津 健太郎

15:45~16:20 「半導体製造における 戦略的優位性としてのコスト競争力」

日本テキサス・インスツルメンツ合同会社 会津工場
進藤 亘

The 34th International Microelectronics Conference Program

Nov.12, 2022

Venue: TKP Garden city Sendai, Hall C, D (21F)

- 13:10~13:45 “Advanced imaging technologies toward semiconductor manufacturing and more”
New Industry Creation Hatchery Center, Tohoku University
Graduate School of Engineering, Tohoku University
Rihito Kuroda
- 13:45~14:20 “A Study on High Precision and High-Speed Time-of-Flight CMOS Image Sensor for Range Imaging”
Graduate School of Engineering, Tohoku University
Chia-Chi KUO
- 14:20~14:55 “A Compressed $N \times N$ Multi-Pixel Imaging and Cross Phase-Detection AF with $N \times 1$ -RGrB+ $1 \times N$ -Gb Hetero
Multi-Pixel Image Sensors”
ICB R&D Center 1, Canon Inc.
Graduate School of Engineering, Tohoku University
Koichi Fukuda
- 14:55~15:10 Break
- 15:10~15:45 “MEMS R&D under open collaboration”
Micro System Integration Center, Tohoku University
Kentaro Totsu
- 15:45~16:20 “Cost Competitiveness as a Strategic Advantage in Semiconductor Manufacturing”
Aizu Fab, Texas Instruments
Wataru Shindo